

ハイテクノロジー

| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 |
|---|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○注目の先端技術と応用技術/高密度実装部品技術 ○わが社の最新半導体 ○コンデンサ技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○新エネルギー関連 ○ノイズ測定と関連測定器 ○車載用半導体デバイス技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○コネクタ技術 ○移動体通信用部品 ○信号処理用アナログデバイス技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○磁性材料/熱対策材料/部品特集 ○自動車用部品技術 ○組込みプロセッサ技術/PLD技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○センサー技術/ワイヤレス通信技術 ○EMC・ノイズ対策部品 ○パワーデバイス技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○電源用部品技術 ○LED及び関連部品・材料 ○ワイヤレス関連デバイス技術 |

| 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12 月 |
|---|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○高周波部品技術 ○電子機器保護用部品技術 ○信号処理用アナログ半導体技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○プリント基板及び実装技術 ○コンデンサー技術 ○ストレージUSB 3.0関連技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○コネクタ技術 ○新エネルギー関連技術 ○半導体パッケージング技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○自動車用電子部品技術 ○センサー技術 ○FPGA/PLD技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○電源モジュールと電源部品技術 ○EMC・ノイズ対策用部品技術 ○高周波デバイス技術 | <ul style="list-style-type: none"> ○抵抗器/新しい照明・ディスプレイ用部品技術 ○高周波部品・モジュール技術 ○電源用半導体デバイス技術 |